**证券代码：688047 证券简称：龙芯中科**

**龙芯中科技术股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  √现场参观 □其他 |
| 参与单位名称 | 长盛基金、东海证券、国泰海通证券、太保资产 |
| 时间 | 2025年7月25日 |
| 地点 | 北京市海淀区中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼 |
| 上市公司接待人员 | 证券事务代表-李琳 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、请更新一下近期产品研发的进展情况？**  以研制成功“三剑客”、“三尖兵”等芯片为标志，龙芯CPU初步具有开放市场性价比竞争力。  龙芯3A6000、3C6000、2K3000通用CPU“三剑客”性价比是上一代产品的3倍以上。桌面芯片产品3A6000自主性强、性价比高，在政策性市场竞争力强，得到客户的认可，去年信息化收入的增长已经有所体现。今年6月公司举办了“2025龙芯产品发布暨用户大会”，发布了服务器产品龙芯3C6000系列和工控/终端芯片2K3000/3B6000M。服务器芯片3C6000系列有16核、32核和64核三个版本，16核3C6000/S、32核3C6000/D实测单核/多核性能分别达到Intel公司2021年上市的16核至强 Silver 4314、32核至强Gold 6338的水平，64核3C6000/Q性能超过40核至强Platinum 8380的水平。结合Intel公司第三代至强可扩展架构服务器芯片出货情况，3C6000系列服务器CPU综合性能达到2023年市场主流产品水平。  龙芯2K0300、1C0203、2P0300嵌入式/专用SOC和MCU“三尖兵”的性价比也很强。2K0300于2024年3月流片成功，年底就形成2-3万片（含板卡）销售，得到若干嵌入式头部企业的认可。高性价比电机驱动专用芯片龙芯1C0203进入市场并与应用迭代。打印机专用芯片2P0300已于2025Q1流片成功并展开产品化工作，性价比与2P0500相比进一步提高，客户基于2P0300的整机研制顺利开展。  **2、公司后续芯片研发的思路和重点？**  2025-2027年研发思路总体原则为优化IP和工艺平台，保持目前研发节奏，聚焦已有产品方向做精做透。桌面和服务器通用CPU形成高、中、低搭配的系列化，嵌入式CPU基于2K0300、2K3000形成系列化，专用CPU在打印机、电机驱动、流量表三个领域系列化做透。  重点研发的芯片包括8核桌面CPU 3B6600、先进工艺服务器CPU、高性能GPGPU 9A2000，性能较之上一代同类型产品都将大幅度提升，其中9A2000规划的图形性能是9A1000的4倍，AI推理性能是9A1000的8倍。  **3、请介绍一下公司软件生态建设情况？**  软件生态建设方面分为夯实基础、广泛兼容、自主应用三个方面。2024年，龙芯积极维护和优化LA架构的开源社区，X86二进制翻译和AI软件生态建设取得突破性进展，龙架构CPU的生态壁垒得到有效破解。夯实基础，在已经建成与X86/ARM并列的龙架构Linux基础软件体系的基础上，后续公司将持续常态化维护并完善LA架构的开源社区，完成龙芯自研GPGPU的GPU驱动开发、AI基础软件及算力框架的建设。广泛兼容，通过持续改进和优化二进制翻译平台，使得在龙芯平台上运行X86/Linux和X86/Windows应用，并开展ARM/Android应用的研发。大力开展自主应用生态建设，首先建设应用基础版操作系统作为龙架构的应用适配和支持平台，后续发展开发者社区和龙芯基础应用，形成自主编程框架，发展自主应用。通用型操作系统包括Loongnix-Desktop，Loongnix-Server、Loonghong，工控平台包括LoongOS、LoongWorks、LoongIDE。 |